

Abstract

Re: DE 100 41 328 A1

The subject matters of document WO/02/17405 are based upon those of DE 100 41 328 A 1. The german abstract is essentially included in the abstract of WO/02/17405. The last sentence of the german abstract, which is not included in the abstract of WO/02/17405, reads in translation " The flexible chip support serves as packaging for the semiconductor chip (1) and can be singulated into single components".



⑯ **Offenlegungsschrift**
⑯ **DE 100 41 328 A 1**

⑯ Int. Cl.⁷:
H 01 L 23/48
B 65 D 73/02
H 01 L 21/58
H 01 L 21/60
H 01 L 33/00

⑯ Aktenzeichen: 100 41 328.5
⑯ Anmeldetag: 23. 8. 2000
⑯ Offenlegungstag: 14. 3. 2002

DE 100 41 328 A 1

⑯ Anmelder:
OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. oHG,
93049 Regensburg, DE

⑯ Vertreter:
Epping, Hermann & Fischer, 80339 München

⑯ Erfinder:
Waitl, Günter, 93049 Regensburg, DE; Brunner,
Herbert, 93047 Regensburg, DE; Bogner, Georg,
93138 Lappersdorf, DE; Lex, Wolfgang, 93092
Barbing, DE

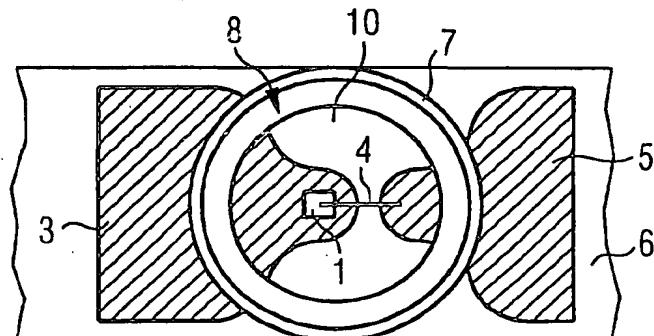
⑯ Entgegenhaltungen:
DE 199 51 865 A1
DE 31 48 843 A1
DE 295 04 631 U1
WO 88 02 533 A1
Feinwerktechnik & Messtechnik, 97 (1989) 11,
S. 485-488;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑯ Verpackungseinheit für Halbleiterchips

⑯ Eine Verpackungseinheit für Halbleiterchips (1) ist von einer Trägerfolie (6) gebildet, auf der metallische Kontakt- schichten (3, 5) ausgebildet sind, mit denen der Halbleiterchip (1) kontaktiert ist. Die Trägerfolie (6) dient zur Ver- packung der Halbleiterchips (1) und kann in einzelne Bau- elemente vereinzelt werden.



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackungseinheit für Halbleiterchips mit einer Vielzahl von auf einem flexiblen Träger aufgereihten Halbleiterchips.

[0002] Derartige Verpackungseinheiten sind allgemein bekannt. Häufig werden Halbleiterwafer vor dem Vereinzeln in einzelne Halbleiterchips mit einer Kunststofffolie lamiert. Nach dem Durchtrennen des Wafers und dem Vereinzeln der Halbleiterchips haften die Halbleiterchips an der Folie und können so gemeinsam weiteren Verarbeitungsschritten, insbesondere Bestückautomat zugeführt werden, wo sie auf Leiterplatten gesetzt werden.

[0003] Ein Nachteil der bekannten Verpackungseinheiten ist, daß sie nach dem Entfernen der Halbleiterchips weggeworfen werden müssen. Dadurch entsteht Abfall, der entsorgt werden muß.

[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine ökologisch sinnvolle Lösung für das Verpackungsproblem zu finden.

[0005] Diese Aufgabe wird erfahrungsgemäß dadurch gelöst, daß an dem flexiblen Träger auch die zur Versorgung der Halbleiterchips erforderlichen Leiterbahnzüge ausgebildet sind.

[0006] Durch die Ausbildung der Leiterbahnzüge auf dem flexiblen Träger wird der flexible Träger selbst ein Element des Bauelements, das gleichzeitig zur Verpackung des Halbleiterchips dient. Gemäß der Erfindung wird der Halbleiterchip nicht vom flexiblen Träger in einer Bestückungsmaschine abgelöst, sondern der flexible Träger wird entsprechend der Aufteilung des flexiblen Trägers in Bauelemente aufgetrennt und die so gewonnenen Bauelemente auf die Leiterplatten gesetzt.

[0007] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist der flexible Träger eine Folie. Dadurch ergeben sich besonders flache Bauelemente. Denn diese Bauelemente werden neben der Folie nur noch vom Halbleiterchip gebildet.

[0008] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist der Halbleiterchip ein Leuchtdiodenchip, der im Zentrum einer auf dem flexiblen Träger ausgebildeten Kavität angeordnet ist. Dadurch ergeben sich Lichtquellen geringer Bauhöhe, die sich insbesondere für Leiterbahndurchbrüche in Mobilfunkgeräten eignen.

[0009] Weitere zweckmäßige Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0010] Nachfolgend wird die Erfindung im einzelnen anhand der beigefügten Zeichnung erläutert. Es zeigen:

[0011] Fig. 1 eine Ansicht auf eine Leuchtdiode gemäß der Erfindung;

[0012] Fig. 2 eine Querschnittsansicht der Leuchtdiode aus Fig. 1;

[0013] Fig. 3 eine Ansicht auf ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Leuchtdiode gemäß der Erfindung;

[0014] Fig. 4 eine Querschnittsansicht der Leuchtdiode aus Fig. 3.

[0015] Die in den Fig. 1 und 2 dargestellte Leuchtdiode weist einen Halbleiterchip 1 auf, der eine Photonen emittierende aktive Schicht 2 aufweist. Mit seiner Unterseite ist der Halbleiterchip mit einer ersten Kontaktsschicht 3 elektrisch leitend verbunden. Die Oberseite des Halbleiterchips 1 ist über einen Bonddraht 4 an eine zweite Kontaktsschicht 5 angeschlossen. Die erste Kontaktsschicht 3 und die zweite Kontaktsschicht 5 sind aus Metallfolien hergestellt, die auf einer Trägerfolie 6 aufgeklebt sind.

[0016] Der Halbleiterchip 1 befindet sich im Zentrum eines ringförmigen Reflektors 7 mit trichterförmig ausgebildeten Innenseite 8. Dadurch ist der Reflektor 7 in der Lage, die vom Halbleiterchip 1 emittierte Strahlung in Richtung

einer Abstrahlrichtung 9 zu lenken. Der Innenraum des Reflektors 7 ist mit einer transparenten Füllmasse 10 gefüllt, in die optische Konversionsstoffe eingebettet sein können.

[0017] In den Fig. 3 und 4 ist ein abgewandeltes Ausführungsbeispiel der in den Fig. 1 und 2 dargestellte Leuchtdiode dargestellt. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist der Halbleiterchip 1 verkippt an der ersten Kontaktsschicht 3 und der zweiten Kontaktsschicht 5 befestigt. In diesem Fall nimmt die aktive Schicht 2 einen rechten Winkel zu der Trägerfolie 6 ein. Diese Anordnung weist den Vorteil auf, daß keine Bonddrähte nötig sind, um den Halbleiterchip 1 an den Kontaktsschichten zu befestigen. Ein Nachteil ist allerdings, daß eine Seite der aktiven Schicht 2 von der Trägerfolie 6 abgedeckt ist. Ferner sind die Oberseite und die Unterseite des Halbleiterchips 1 wenigstens teilweise mit Material bedeckt, daß zur Befestigung des Halbleiterchips 1 an der ersten Kontaktsschicht 3 und der zweiten Kontaktsschicht 5 verwendet wird. Im Vergleich zu dem in den Fig. 1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ist daher bei der Leuchtdiode gemäß den Fig. 3 und 4 die Lichtausbeute geringer.

[0018] Als Material für die Trägerfolie 6 kommen vor allem temperaturfeste und metallisierbare Kunststofffolien in Frage. Beispielsweise kann die Trägerfolie 6 eine aus Epoxidharz basierende Trägerfolie sein oder aus Polyimid oder einem Polyester, zum Beispiel aus Poly-Ethylenglykoldi-Naphthalat gefertigt sein. Als Werkstoff für den Reflektor 7 eignen sich insbesondere temperaturfeste und optisch reflektierende Materialien wie Poly-Phthalimid (PPA), Liquid Crystal Polymer (LCP) sowie Poly-Ether-Ether-Keton (PEEK). Daneben kommen auch weitere Thermoplaste in Frage, sofern sie nur temperaturfest und optisch reflektierend sind. Derartige Thermoplaste können durch eingebettete Pigmente eine sehr hohe Reflektivität aufweisen.

[0019] Die Materialien sind so gewählt, daß der Reflektor 7 auf der Trägerfolie 6 haftet. Um die Festigkeit der Verbindung zwischen Reflektor 7 und Trägerfolie 6 zu verbessern, können in der Trägerfolie 6 Ausnehmungen 11 vorgesehen sein, in die der Reflektor eingreift.

[0020] Als Material für die Füllmasse 10 kann eines der üblichen Gießharze verwendet werden. Als Material für die Füllmasse 10 kommt beispielsweise Epoxidharz, Silikon oder acrylatähnliche Verbindungen in Frage. Als Konversionsstoffe eignen sich Titandioxid, Bariumoxid, Zirkoniumdioxid sowie Dialuminiumtrioxid.

[0021] Zur Herstellung der Leuchtdioden wird zunächst auf die Trägerfolie 6 eine Metallfolie aufgeklebt und anschließend mit einer Photolackschicht beschichtet. Die Photolackschicht wird belichtet und anschließend werden die Photolackschicht und die Metallfolie durch ein übliches Ätzverfahren strukturiert. Daraufhin werden die Reste der Photolackschicht entfernt und die Reflektoren 7 auf die Trägerfolie 6 aufgespritzt. Anschließend erfolgt das Einsetzen der Halbleiterchips 1 in den Innenraum der Reflektoren 7. Nach dem Bonden der Halbleiterchips 1 wird der Innenraum der Reflektoren 7 mit der Füllmasse 7 gefüllt. Die Trägerfolie 6 wird anschließend gefaltet oder aufgerollt, so daß eine handhabbare Verpackungseinheit für die Leuchtdioden entsteht.

[0022] Bei den in Fig. 1 bis 4 dargestellten Ausführungsbeispielen ist die Trägerfolie 6 bandförmig ausgebildet, wobei die Leuchtdioden auf der Trägerfolie 6 aufgereiht sind. Abweichend davon kann die Trägerfolie 6 auch so breit gewählt werden, daß mehrere Bahnen von Leuchtdioden nebeneinander Platz finden.

[0023] Außerdem ist es möglich, mehrere Exemplare der Halbleiterchips 1 innerhalb der Reflektoren 7 anzuordnen und so mehrfarbige Leuchtdioden zu erhalten.

[0024] Ferner ist es möglich, auch die Rückseite der Trä-

gerfolie 6 mit einer Metallisierungsschicht zu versehen, um bei Hochfrequenzanwendungen Störwellen abzuschirmen. [0025] Die hier beschriebenen Leuchtdioden zeichnen sich durch einen geringen Platzbedarf aus, da keine federnen metallischen Anschlußbeinchen vorgesehen werden müssen. Denn die flexible Trägerfolie 6 kann ohne Schwierigkeiten an verschiedene räumliche Gegebenheiten angepaßt werden. Da ferner die Trägerfolie 6 im allgemein dünn ausgebildet ist, weisen die Leuchtdioden im allgemein eine geringe Höhe auf. Es ergeben sich daher besonders flache Bauelemente. 10

[0026] Ein weiterer Vorteil sind die ähnlichen Ausdehnungskoeffizienten der für die Trägerfolie 6 und den Reflektor 7 verwendeten Materialien. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Leuchtdioden bei Temperaturzyklen sehr hoch. 15

[0027] Schließlich ist noch von Vorteil, daß die Trägerfolie 6 zum Verpacken und zum Transport der Leuchtdioden verwendet werden kann. Falls die Leuchtdioden für eine Tastaturhinterleuchtung eines Mobilfunkgeräts verwendet werden soll, kann die Trägerfolie an der Montagelinie für die Mobilfunkgeräte zerteilt werden und die vorgesehenen Gruppen von Leuchtdioden gemeinsam in das Mobilfunkgerät eingesetzt werden. Zweckmäßigerweise sind bei einer derartigen Anwendung bereits die zur Ansteuerung der Leuchtdiodenchips erforderlichen Schaltkreise auf der Trägerfolie 6 ausgebildet. 20 25

[0028] Die Erfindung wurde hier anhand von Leuchtdioden erläutert. Es ist jedoch denkbar auch andere Halbleiterchips auf die beschriebene Art und Weise zu verpacken und handhabbar zu machen. 30

bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Kavität (7) mit einer Füllmasse (10) gefüllt ist.

7. Verpackungsmaterial nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Füllmasse (10) für das von den Leuchtdiodenchips (1) ausgehende Licht transparent ist.

8. Verpackungseinheit nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß optische Konversionsstoffe in der Füllmasse (10) eingebettet sind.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Halbleiterchip	35
2 aktive Schicht	
3 Kontaktsschicht	
4 Bonddraht	
5 Kontaktsschicht	
6 Trägerfolie	
7 Reflektor	40
8 Innenseite	
9 Abstrahlrichtung	
10 Füllmasse	

Patentansprüche

1. Verpackungseinheit für Halbleiterchips (1) mit einer Vielzahl von auf einem flexiblen Träger (6) aufgereihten Halbleiterchips (1), dadurch gekennzeichnet, daß an dem flexiblen Träger (6) auch die zur Versorgung der Halbleiterchips (1) erforderlichen Leiterbahnzüge (3, 5) ausgebildet sind. 50
2. Verpackungseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Halbleiterchips Leuchtdiodenchips (1) sind. 55
3. Verpackungseinheit nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Leuchtdiodenchips (1) in einer auf dem flexiblen Träger (6) ausgebildeten Kavität (7) angeordnet sind.
4. Verpackungseinheit nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kavität als Reflektor (7) ausgebildet ist. 60
5. Verpackungseinheit nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiterbandzüge (3, 5) auf einer Vorderseite und eine ganzflächige Metallisierung auf einer Rückseite des flexiblen Trägers (6) ausgebildet sind. 65
6. Verpackungseinheit nach einem der Ansprüche 3

FIG 2

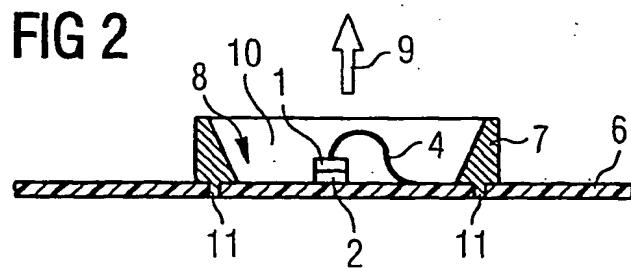


FIG 1

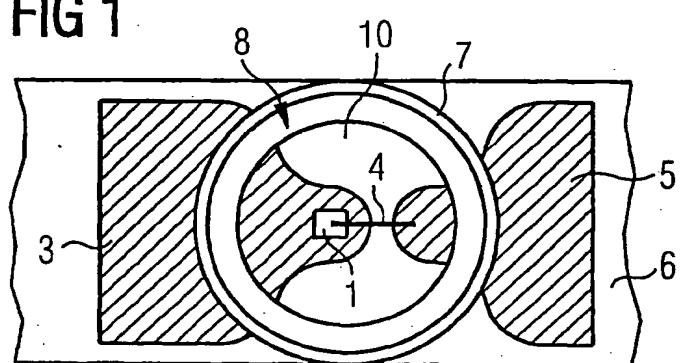


FIG 3

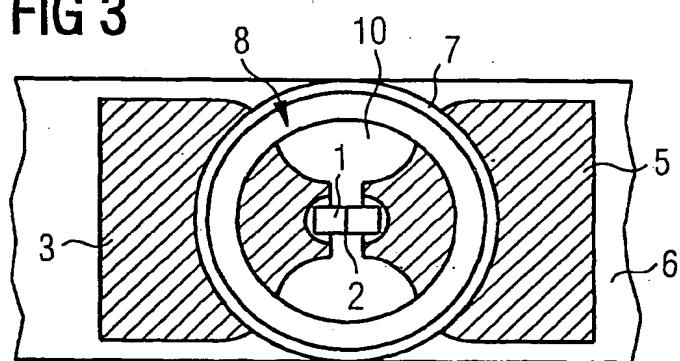


FIG 4

